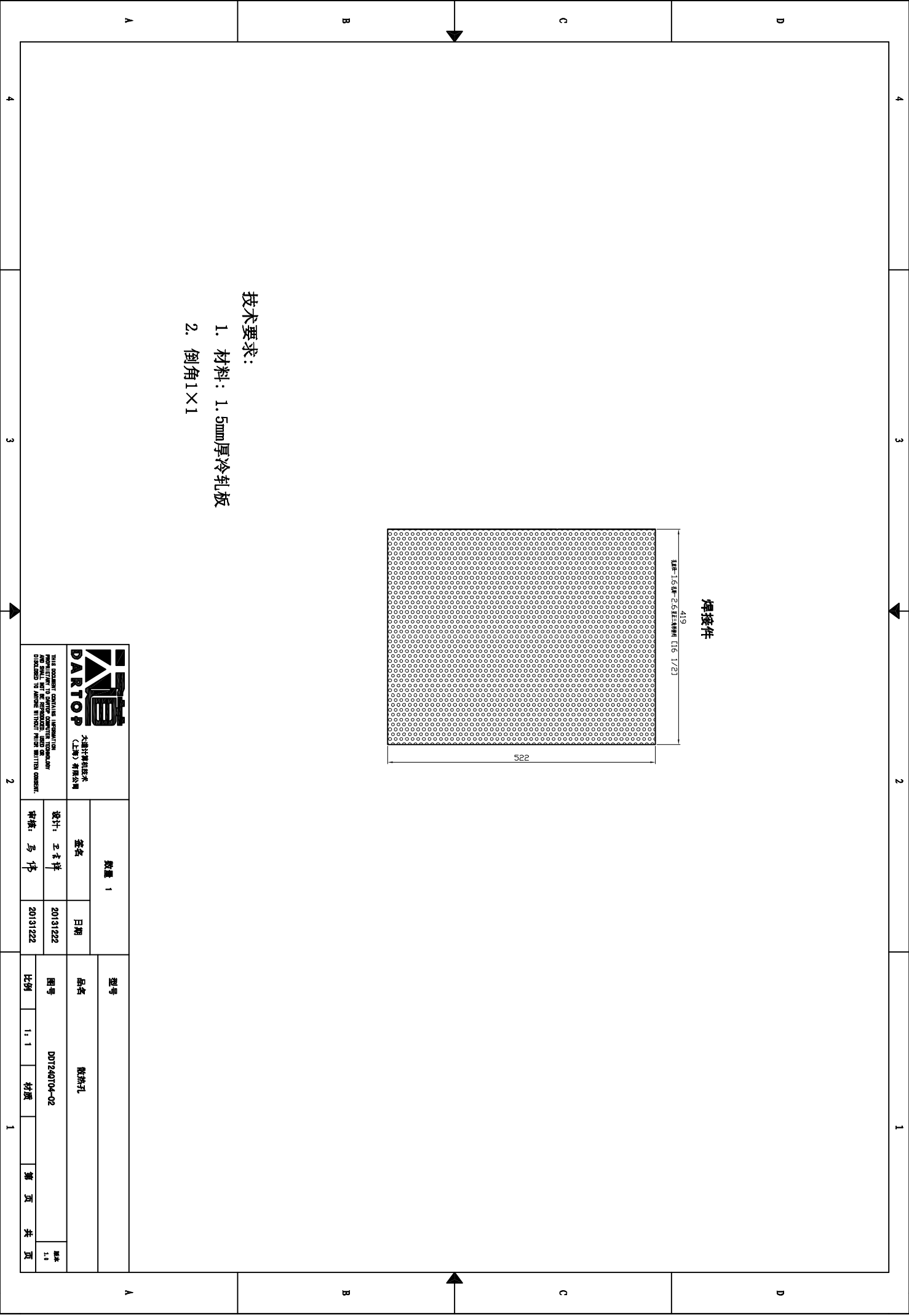


技术要求:

1. 材料: 1mm厚冷轧板
2. 倒角1×1

<div><div>大道</div><div>DARTOP</div><div>大道计算机技术(上海)有限公司</div></div>		数量 1		型号			
设计: 王东洋		日期: 20131222		品名: 24寸箱体正面下封板			
审核: 马伟		比例: 1: 1		图号: DD724DT04-01			
20131222		材料:		第 1 页 共 1 页			
1.0		1.0					



焊接件

技术要求:

1. 材料: 1.5mm厚冷轧板
2. 倒角1×1

<div>大道DARTOP</div> <div>大道科技(上海)有限公司</div> <div>THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION. IT IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED, OR DISCLOSED IN ANY MANNER WITHOUT WRITTEN CONSENT.</div>		数量 1		型号		
		设计: 王东洋	日期: 20131222	品名: 散热孔	图号: D07240T04-02	
		审核: 马伟	20131222			版本: 1.0
				比例: 1:1	材质:	第 1 页 共 1 页



